BL40XU 高フラックス

本ビームラインはヘリカルアンジュレータを光源と し、分光器を使用せずに2枚の全反射ミラーでビームを 集光することにより、準単色の高輝度X線ビームを使用 できるビームラインである。これらのビーム特性を活か して、回折、散乱、XAFS、イメージングなど、多様な 利用実験が行われている。本ビームラインには共同利用 実験に供されている実験ハッチ1と、CREST研究プロ ジェクトにより建設された実験ハッチ2がある。

1. 実験ハッチ1

実験ハッチ1では、非結晶試料の時分割X線回折、X 線1分子計測、マイクロビーム回折・散乱実験等が行わ れている。

2016年度末に導入した薄型で小型(厚さ20 mm、 幅70 mm、高さ115 mm)のピクセルアレイ検出器 Modupixの新たな利用検討を行った。Modupixは、 CERNで開発されたTimePixチップをベースとし、ピク セルサイズ55 μm角で検出面積は14 mm角(256×256 ピクセル)である。各ピクセルに入射したフォトン数を 数えるフォトンカウンティングモードの他に、各ピクセ ルに到達したフォトン到達時間を記録するToA(Time of Arrival) モードが利用可能である。データ読み出し 時間5ミリ秒程度で利用できるため、小角・広角同時計 測時の広角高速測定用の検出器としての利用が可能であ るが、新たにToAモードについて、回折点の動きを高 速に捉えるX線1分子追跡法・実験への応用を検討した。 ToA モードでは100 nsといった高時間分解でフォトン の位置情報が取得可能であるため、この機能を最大限に 活用することで、高時間分解、かつ低ドーズで回折斑点 の動きをモニターすることが見込まれる。

図1-Aは、金粉末(325 mesh, Nilaco AU-174019)を ポリイミドフィルムで挟み込んだ試料をガルバノスキャ ナ(千葉シチズンGVM-2510)の軸上に配置させ、傾 斜方向に三角波状に往復走査させた(50度/秒)時の ToA像である(クロック1 MHz, 10 ms/frame, 閾値エ ネルギー14 keV, サンプル-検出器距離120 mm)。入射 光は14.5-16.5 keV のピンクビームを用いた。ToAイ メージでは到達時刻を色(カウント)として表現する。 図1-Aでは左から右方向に移動した軌跡と解釈できる。 このようなToA イメージを連続撮影し(リードアウト5.1 ms)、各々の回折フォトンの到達位置と時刻から回折 フォトンの時系列変化を再構成したのが図1-Bである。 50度/秒の想定される軌跡(太実線)とフォトン到達情 報プロットが一致し、走査角速度を精度よく捉えられて いることがわかる。図1-Cは10度/秒走査時のToA連 続画像から再構成したもので、図1-Bと同様に角速度に 反映した軌跡を捉えている(ただし、位置精度は悪い)。 ToAイメージングでは、各ピクセルに入射される第一 フォトンのみに着目するため、ノイズとなるフォトン を極力落とす必要がある。入射X線のビーム径を10 µm の以下にすること、フォトン検出閾値を高く設定するこ と(入射X線と同程度)、入射X線を従来の1/100程度 に抑えることなどが有効であった。これらの操作はサン プルのX線に対するダメージ回避に有効であり、限られ たドーズ量で回折点移動を捉える、あるいは長時間観察 を行う際に有効である。







図2 光子計数型ハイブリッド検出器を利用した測定時の様子

2. 実験ハッチ2

実験ハッチ2では、ピンポイント構造計測装置を利用 した集光X線による極微小単結晶構造解析や、シングル バンチからのピコ秒X線パルスを利用した次世代エン ジンの燃料噴射ノズル開発のためのX線イメージング 実験や半導体材料のポンププローブ分光実験が行われて いる。

微小単結晶X線構造解析実験においては合成化学系の ユーザーが多いこともあり、一度のマシンタイムに大量 の試料を測定する。また、X線だけでなく空気や湿気に よって劣化が進行する不安定な物質の測定も行われる。 そのため、測定時間を短縮してスループットを向上させ るとともに、ダイナミックレンジを広くして高精度な回 折強度測定を実現するため、CCD検出器に代わり光子 計数型ハイブリッド検出器であるDECTRIS社製EIGER X 1Mをピンポイント構造計測装置に導入し、立ち上げ を行った(図2)。

本検出器は光子計数型の検出器であり導入にあたり特 に以下の点を重視して選定した。

- 1) 読み出し時間:3マイクロ秒
- 2) 検出面積:77.2 × 79.9 mm²
- 4) 最大フレームレート: 3,000 Hz
- 5) 高ダイナミックレンジ (32 bit)
- 6) 読み取りノイズ、暗電流がない

イメージ間の読み出し時間を短くしてデータの欠損を なくし、高フレームレート動作を行うことでアンジュ レータの高強度X線を利用した短時間測定でも十分小 さなω振動角(Δω)で回折イメージを取得できる。ま た、広いダイナミックレンジとノイズフリーである特徴 を活かし詳細な回折ピーク形状が測定できる。さらに、

表1 EIGER で測定したデータ比較

	Fast scan	Slow Scan
試料	シチジン(C₃H₁₃N₃O₅)	
ω (°)	-90~90	
$\Delta \omega$ (°)	1	
露光時間(s)	0.1	5
φ (°)	0, 90, 180, 270	
$2 heta_{ m max}$ (°)	5	6.2
λ (Å)	0.78203	
測定反射数	11550	11597
独立反射数	1910	1927
R_{int}	0.0842	0.0254
R_1 (I>2 σ (I))	0.0252 (558反射)	0.0260(1905反射)
R_{w^2}	0.0409	0.0678
GOF	0.349	1.083
Flack	2.2 (10)	-0.1 (2)

検出面積はわずかであるがCCDよりも広くなる一方で 筐体寸法は小さいため、CCD利用を希望する場合の装 置入れ替えも容易に行えるようになっている。

制御ソフトは、Labview(National Instruments)に よって作製したソフトウェアでEIGERやゴニオメータ などすべての機器を制御しており、基本的な測定であれ ば、ウインドウ1つだけで測定が行えるようになってい る。また、測定データの解析も既存ソフトが利用できる ようにイメージ変換プログラムを作製した。

導入直後に装置評価を行うために標準試料(シチジ ン、C₉H₁₃N₃O₅)の測定を行った。読み出し時間が短い ため、装置シャッターを開けたままで ω 軸を-90度か ら90度まで連続駆動させながらX線を照射して測定を 行っている(シャッターレス測定)。表1には比較的早 い ω 軸回転での測定(Fast Scan、総露光時間72秒)と 露光時間を長めに設定し統計精度を上げた測定(Slow Scan、総露光時間1時間)の測定結果を示している。 Slow Scan がCCDと同程度の測定時間であるが、R値 はFast Scanにおいても同程度であり、これは単に立体 構造を知りたい測定であれば1分程度の測定で十分なこ とが確認された。

2018A期からは本格的なユーザー提供を予定しており、測定イメージに対して強度補正を行うことで精度を 向上させることが可能になるため、測定法の確立やユー ザーの利便性と合わせて改良を進めている。

JASRI 利用研究促進部門

回折・散乱Iグループ

関口 博史、岩本 裕之、青山 光輝 安田 伸広、福山 祥光